

## パッケージ基板向け直接描画装置「Ledia Qs」を発売

株式会社SCREEN PE ソリューションズはこのほど、パッケージ基板に対応する直接描画装置の高精細モデル「Ledia Qs」を新たに開発。2024年6月から販売を開始します。



### Ledia Qs

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、下記URLよりダウンロードできます。  
([www.screen.co.jp/about/nr-photo\\_2024](http://www.screen.co.jp/about/nr-photo_2024))

近年、5GやIoTインフラの普及に加え、生成AIなど新たな技術領域の進展に伴い、データセンターを中心に半導体デバイスへの需要は世界規模で拡大しており、プリント基板業界においても、半導体デバイスを搭載するパッケージ基板を中心としたハイエンド基板分野では今後も投資が続くと見込まれています。

これまでハイエンド基板向けのソルダーレジスト露光工程においては、ステッパーを中心に採用が進んでいましたが、位置精度要求の高まりのほか、解像性、利便性などの面から、それらの要求に応える直接描画装置の登場が期待されていました。

こうした業界のニーズを受け、「Lediaシリーズ」の最新モデル「Ledia Qs」を開発しました。本装置はブロード波長型露光装置としては業界最高の解像力を誇る当社独自の露光ヘッドをベースに、昨年発表した「Ledia 8F」で開発した技術を融合することで、高い描画品質と安定した描画位置精度を両立しています。

今回の「Lediaシリーズ」のラインアップ拡充により、成長が続くプリント基板市場でのビジネスを加速させるとともに、今後も電子機器業界のさまざまなニーズに応え、同業界の発展に貢献していきます。